

洗淨のことなら 化研テック

インターネットコンジャンパンに出展します！
(東4ホール E5-8)

●フラックス洗淨
●ペースト・樹脂洗淨
●パーティクル洗淨
●IPA・有機溶剤代替 など
幅広い洗淨ソリューションを
提案いたします。



削る・切る・詰る・観る

株式会社 サンテック

ISO9001、14001 認証取得

エレクトロニクス業界向け
微細加工 EXPO
東6展示場 E19-11

技

シリコン→SiC、GaN、
異種貼合せ品、複合
ガラス etc

知恵

「0」→「1」に
生み出す現場力

未来にコミット

「Co₂削減」(SBT)
「ポジティヴ・インパクト・
ファイナンス」
(日本格付研究所)

SDGs

HTT取組
推進宣言企業
(太陽光発電+蓄電+省エネ) etc

ものづくりだけではない 付加価値も共に

<https://www.c-suntec.co.jp/>

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10 TEL 042-557-7744(代) FAX 042-557-7745

DMB(Dot Matrix Bonding)超音波接合

熱をかけずに、面でつなぐ。

●熱をかけない接合

●面に近い接合

●高熱伝導接合

DMBシートバリエーション

インターネットコンジャンパンに出展

接合初期
接合完了

adwelds 株式会社アドウェルズ www.adwelds.com 092-555-6000



同時開催展全体で約1850社・団体が出展し、約9万2000人の来場を見込む

最新の製品・デモ一体感

●電子部品・材料 EXPO
スマートフォンをはじめとする電子機器の高機能化・軽薄短小化を支える電子部品・電子材料が展示されるのは「電子部品・材料 EXPO」。

●プリント配線板 EXPO
スマートフォンをはじめとする電子機器の高機能化・軽薄短小化を支える電子部品・電子材料が展示されるのは「電子部品・材料 EXPO」。

7 構成展

実装の関連技術最前線

モノづくりは AI で大変革期

●インターネットコンジャンパン
「インターネットコンジャンパン」は最新のエレクトロニクス製造・実装に関する最新、最先端の技術・製品・サービスを紹介する、「ネプコンジャパン」のコアとなる展示会。米オープンAI「ChatGPT」や米グーグル「Gemini」といった生成AI（人工知能）の利用が拡大し、モノづくりは大きな変革の時期を迎えている。同展ではAIの進化を支える電子部品・機器の生産技術、製造装置などのいまを知ることが出来る。

●エレクトロテスト ジャパン
インターネットコンと同時にスタートした「エレクトロテスト ジャパン」はエレクトロニクス検査・試験・測定の専門展。モノづくりが高性能・高精度化していく中で、コストダウンや市場投入へのスピードアップも求められており、検査・試験・測定の重要性は高まっている。同展には外観・X線検査装置、テスト台、環境試験・信頼性試験装置、各種分析装置などあらゆる検査・試験装置の主要メーカーが出展する。

●電子部品・材料 EXPO
スマートフォンをはじめとする電子機器の高機能化・軽薄短小化を支える電子部品・電子材料が展示されるのは「電子部品・材料 EXPO」。

●プリント配線板 EXPO
スマートフォンをはじめとする電子機器の高機能化・軽薄短小化を支える電子部品・電子材料が展示されるのは「電子部品・材料 EXPO」。

セミナー

毎回、業界のトッププラランナー企業との関係者が講師をつとめるネプコン ジャパンのセミナー。21日10時から15時までは「電子部品・材料 EXPO」のセミナー。22日10時から15時までは「プリント配線板 EXPO」のセミナー。23日10時から15時までは「エレクトロテスト ジャパン」のセミナー。24日10時から15時までは「インターネットコンジャンパン」のセミナー。25日10時から15時までは「エレクトロテスト ジャパン」のセミナー。26日10時から15時までは「インターネットコンジャンパン」のセミナー。27日10時から15時までは「エレクトロテスト ジャパン」のセミナー。28日10時から15時までは「インターネットコンジャンパン」のセミナー。29日10時から15時までは「エレクトロテスト ジャパン」のセミナー。30日10時から15時までは「インターネットコンジャンパン」のセミナー。

ネプコン ジャパン 1月21日-23日 / 東京ビッグサイト

つなぐ技術で、ウェアラブルの未来を切り拓く

スマートテキスタイル対応

RK01シリーズ
ワンアクション簡説
家庭用洗濯機で洗濯可能

RK02シリーズ
ピッチ変換シート採用
家庭用洗濯機で洗濯可能

モバイル機器用

ST51シリーズ
microSD™ EXPRESSカード用
カード簡説押し・押しタイプコネクタ

DX07シリーズ
USB Type-C®準拠
インターフェイス用コネクタ

WP56MSシリーズ
スタッキング高さ0.6mm、
奥行1.73mm(SMT含む奥行1.9mm)

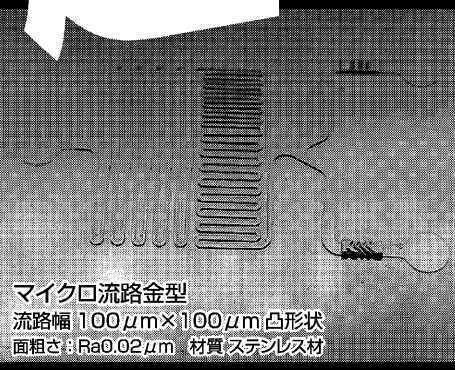
最小クラス*
コネクタ高さ: 1.4mm
*2025年10月時点 当社調べ

USB4®
最大240W対応

0.3mmピッチ
5A電源端子付き

電子部品・材料 EXPO
(当社ブース) 東7ホール / No.E36-13

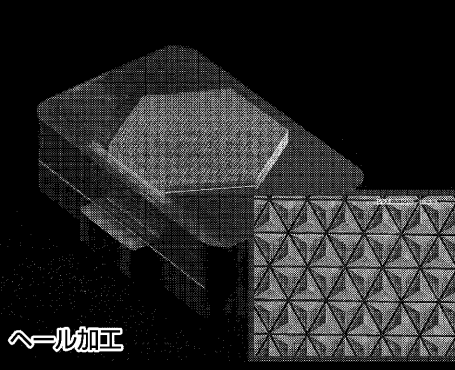
超微細加工なら...



マイクロ流路金型
流路幅 100μm×100μm 凸形状
面粗さ: Ra0.02μm 材質: ステンレス材



マイクロリードルベスター
ロケッド形状: 0.05mm×長さ1mm
材質: ステンレス材



ホール加工

ミクロンの最高峰へ ±0.001mmのものづくり

Y-MOLD株式会社

〒399-3304 長野県下伊那郡松川町大島402-12
TEL: 0265-36-5476 FAX: 0265-36-6309

ブース No.
東5ホール
E-19-36

表面処理でコストダウンを実現

革新的な電着技術で信頼を得る

株式会社シミズ

半導体・センサパッケージング技術展 小間番号: E30-39

表面処理一筋

表面処理の新時代を追求する
株式会社 **シミズ**

本社 / 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4-11-23
TEL: 072-965-8888 FAX: 072-965-8889
✉ busi@shimizu-corp.co.jp
https://shimizu-corp.co.jp

電子部品・材料 EXPO

チノール

チノールは電子部品業界で活躍する温度計測・制御機器を主体としたシステムを展示する。
積層セラミックコンデンサー（MLCC）の量産に向けた連続焼成炉の制御システムは、計装モジュール「SBシリーズ」を用いて精密な温度制御から監視までを一括で行う。省スペース、データの一元管理などが可能となる。
また、ヒーターの交換時期を知らせる劣化診断システムは、拡散炉などで突発的に起こるヒーター故障による停止リスクを低減する。このほか、アーク放電や炎など瞬間温度500℃で測定し、ガラス越しでも最大2600℃まで計測可能な高速高機能熱画像計測装置などを展示する。

シンフォニアテクノロジー

シンフォニアテクノロジーは電子部品製造のサポートを行うさまざまな製品を展示する。
独自の振動制御であらゆる方向へ部品供給が可能な振動搬送テーブル「トリプレート」を応用した振り込み機のほか、電子部品やLEDなど微小部品の安定供給が可能で、新型圧電駆動部によりさらなる高速供給を実現した高速パーツフィーダー「レゾテック」などを出品する。
また、高精度な位置決めには欠かせないダイレクトドライブモーターや、産業ロボットで豊富な実績を誇る電磁クラッチ/ブレーキなど、自動化に貢献する製品も展示し、幅広い製品ラインアップを紹介する。

日本航空電子工業

日本航空電子工業はウェアラブルデバイスに最適な接続技術を提案する。家庭用洗濯機で洗濯可能な小型のスマートテキスタイル対応コネクタ「RKシリーズ」は、医療分野での活用例をマネキン実装デモで披露。ファブリックから音を出す刺繍スピーカー搭載枕の実装例も展示する。
ワイヤレスイヤホンなどのウェアラブル機器を分解したイメージパネルでは、基板対基板（FPC）用の小型・低背型コネクタ接続例と豊富なラインアップを紹介。USB Type-Cコネクタ「DX07シリーズ」は利用用途に応じた多彩なバリエーションを取りそろえる。
さらに、曲げ部で回路接続が可能なフレキシブルコネクタ「flex-stack」も参考出展する。

ネプコン ジャパン

1月21日～23日

高速パーツフィーダー

レゾテック
RESOTECH™

振動搬送テーブル

トリプレート

電子部品 半導体 ロボット

様々な製造の効率化・自動化をサポート

ダイレクトドライブモータ

アライナー

※参考出展

無励磁作動形ブレーキ

第40回 ネプコン ジャパン

エレクトロニクス開発・実装展

1/21※～1/23※ 東京ビッグサイト
東7ホール E37-38

SINFONIA

シンフォニアテクノロジー株式会社

東京本社 〒105-8564 東京都港区芝大門1-1-30 芝タワー
振動機営業部（パーツフィーダー） ☎ 03-5473-1837
FAシステム営業部（クラッチ/ブレーキ） ☎ 03-5473-1824
FAシステム営業部（FAソリューション） ☎ 03-5473-1827

当社 Webサイト

パワーデバイス&モジュール EXPO

アドウェルズ

アドウェルズはトット・マトリックス・ボンディング（DMB）を用いた超音波接合技術と参考サンプルを出展する。微細突起付きDMBシートを材料間に挟み、突起部へ荷重と超音波を集中させることで、低温・低荷重でも大面積を均一に接合が可能。ベース板/AMBやDB/C基板接合、シリコン（Si）や炭化ケイ素（SiC）のチップ接合に適用し、ダイレクト接合することによって放熱性向上に貢献する。
銅（Cu）・銀（Ag）などのシートラインアップがあり、パターンレス接合も提案。会場ではサンプルを展示し、ニーズとのマッチングを確認できる。技術メンバーとの技術・試作テスト相談も可能。

エレクトロテスト ジャパン

レーザーテック

レーザーテックはコンフォーカル光学系を用いた検査・測定装置を出展する。微細形状の観察・測定を行う多機能コンフォーカル顕微鏡「OPTELICS HYBRID+」や、高速自動検査・測定に特化した「OPTELICS S AI2」「BI-Mシリーズ」を紹介。これらは透明試料でも裏面反射の影響を受けずに検査・測定が可能だ。
このほか、先端半導体の内部観察・測定が可能な「OPTELICS IR」、多光子励起フォトルミネッセンスによる化合物半導体内部の3D解析を実現する「OPTELICS UXM」などを出展。R&Dから量産まで各フェーズに対応できるさまざまなソリューションを提供する。

微細加工 EXPO

サンテック

サンテックは国内外700社以上の企業・大学・研究機関からシリコンウエハーやガラス基板などのダイシング加工を受託している。
展示会では「目で見てわかるダイシング加工」と題し、ミラーウエハーのチップ化までの工程を加工サンプルで説明する。このほかSiC（炭化ケイ素）やサファイア、貼り合わせ品など加工可能な素材サンプルも展示。
また、ダイシングメーカでは唯一無二のマシニング加工や、装置メーカーと共同開発の「マルチサークルカット」、新サービス「ダイシングの加工体験」などをパネル展示する。独自のノウハウと最先端装置を駆使し、切るものの素材を選ばない加工技術を提案する。

制御性と効率が一歩に進化

新型卓上はんだ付ロボット UNIX-DFR シリーズ

ワンタッチで交換できる、
新型UHヒータに
標準対応※

CC-Link・EtherNet / IP・
Profinetなどの
フィールドバスに対応

※UNIX-DFR204Sは非対応

IPCセミナー情報

はんだ付の国際認証資格
CISトレーニング

IPC-7711 / 21 CIS新規セミナー
2026年
3月10日(火)～13日(金)

2026年4月以降も順次開催!

場所 東京会場(㈱ジャパンユニックス本社)
お問い合わせ tel.03-3588-0551 (IPC担当)

IPC標準規格

世界の製造業が採用 品質標準のグローバルスタンダード

電子組立品の許容基準
[IPC-A-610JP]

プリント板の受け入れ
[IPC-A-600JP]

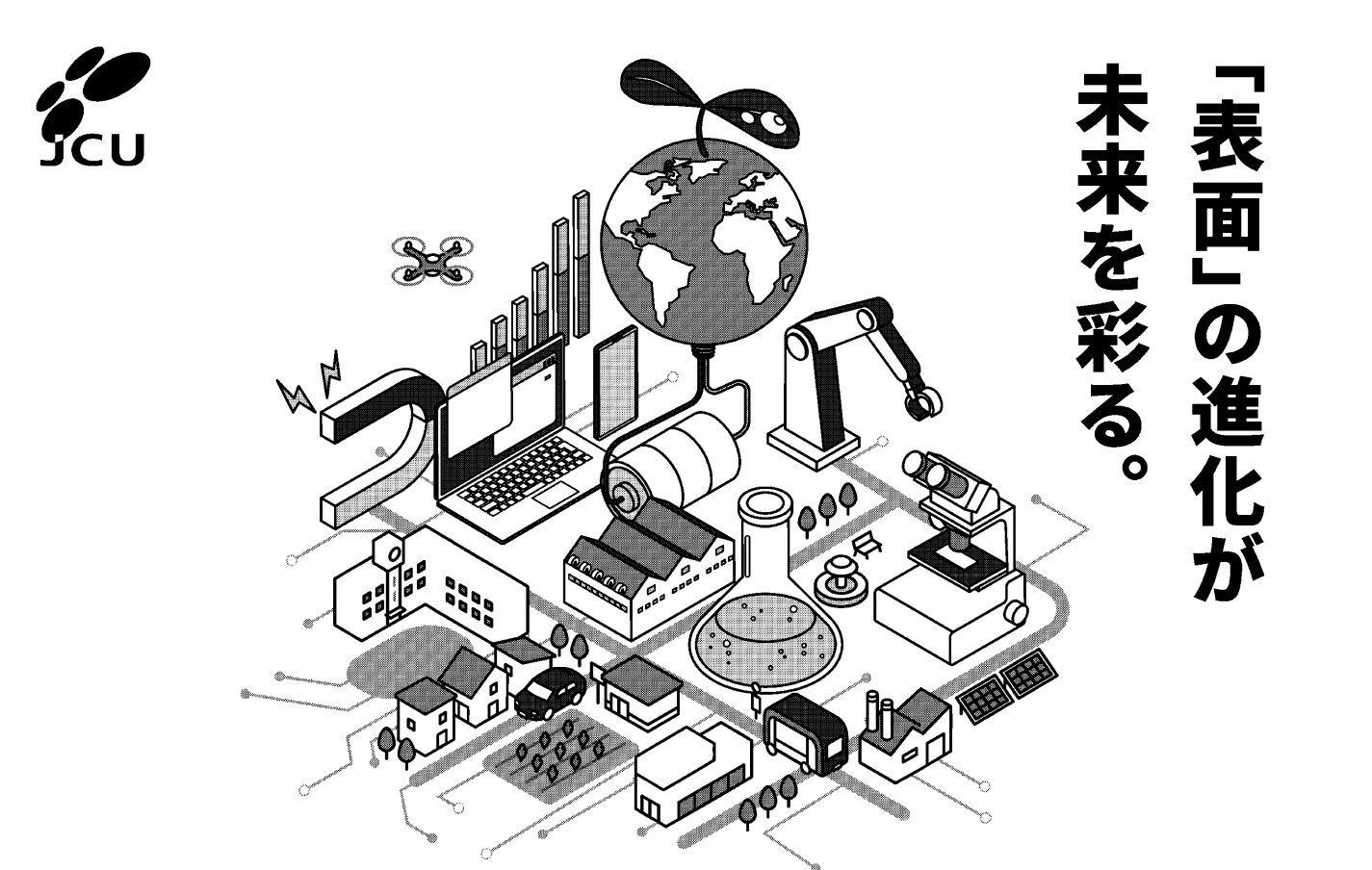
お問い合わせ tel.03-3588-0551 (IPC担当)
オンライントレーニング https://training.ipcstore.jp

「相談から量産まで」支援するはんだ付のプロフェッショナル

JAPAN UNIX 株式会社 ジャパンユニックス http://www.japanunix.com

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-25 Tel. 03-3588-0551 Fax. 03-3588-0554
大阪営業所 Tel. 06-6190-4580 Fax. 06-6190-4581 名古屋営業所 Tel. 052-679-2111 Fax. 052-679-2112 熊本テクノセンター Tel. 096-287-4501 Fax. 096-287-4503

「表面」の進化が未来を彩る。



表面処理技術から未来を創造する

Explorer in Surface Engineering

私たちは、創業以来、装飾・防錆めっき技術から発展した様々な表面処理技術の提供で、自動車、エレクトロニクスなどの産業の成長を支えてきました。これからも、長年培った知見と研究・開発力で、新たな表面処理技術を追及し、ものづくりを支え、世界中の人々の豊かな生活に貢献します。

株式会社 JCU

本社 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 16階 TEL: 03-6895-7001 FAX: 03-6895-7021
国内拠点: 本社 大阪支店 九州営業所 名古屋支店 総合研究所 生産本部 熊本事業所
海外拠点: 中国 台湾 韓国 メキシコ アメリカ ベトナム タイ インドネシア インド マレーシア